



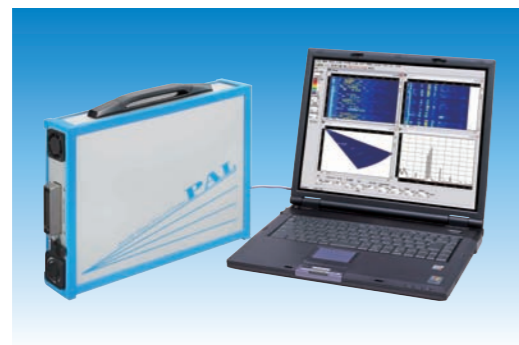
フルデジタル超音波探傷映像化装置 SDS-WIN[®]

●主な仕様

超音波探傷器 HIS3 HF	
パルサ出力	-200V (無負荷)
パルサ立ち下がり時間	1.0ns以下
レシーバ帯域	1.0~300MHz (-3dB)
ゲイン調整範囲	0~71dB/1dB
ビーム路程計測	0~40.96μsec
CPUコントロール	パラレル I/O、RS232C 各1
スキャナ (6軸スキャナ標準仕様)	
走査範囲 (mm)	X: 500mm-Y: 400mm-Z: 300mm R/ターンテーブルφ300 θ1/110° θ2/±45°
走査速度	max. 300mm/sec.
収録ピッチ	0.01~9.99mm/sec. (X-Y-Z) 0.02~9.98° (R: ターンテーブル)
走査モード	平面、側面、斜面、R面 (薄錐形)、円柱、球面、連続
水槽容積	705×655×440mm (W-D-H)
その他	走査エリアティーチング、ジョグリモコン機能
データ処理	
データ収集点数	max. 40,000,000点 (一回の走査収録)
データ保存	①HDD ②DVD-RW ③USBポート
設定条件保存	HDD (探傷器とスキャナ設定) 他
画像処理ソフト	階調表示 : 2色間256階調 (白黒含む1600万色中より任意選択) カラー16階調、RYB256階調 エコー評価 : 音圧階調、深さ階調、MURAI階調 リアルタイム処理 : 平面像、断面像、透視像、立体像、ワイヤーフレーム 精密探傷 (ズームアップ探傷)、映像内測定、拡大、 カーソル位置行き、面積率、設定表示、エコー高さ表示、 エコー高さ透視、指定点データ読みとり 他
	LAN対応可能
一般	
外形寸法	コンソールデスク : 1400×800×700mm (W-D-H) 6軸スキャナ : 1150×1100×1750mm (W-D-H)
重量	コンソール部 : 150Kg 6軸スキャナ : 350Kg
電源	AC100V (±10%) 1.5kVA

※スキャナ部は各種選択可能です。ご相談下さい。

その他の日本クラウトクレーマー取扱商品



●ポータブルフェイスドアレイ超音波探傷装置 PAL3



●マルチチャンネル型自動超音波探傷システム USI-α

※本カタログの記載内容は平成22年10月現在のものです。記載事項は予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。
※写真の製品の色は印刷により実際の色とは多少異なる場合があります。

INDESで未来を創造する
日本クラウトクレーマー株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-13-13 東都自動車ビル4F
TEL (03) 3987-8711 FAX (03) 3987-8716
大阪事業所 〒578-0912 大阪府東大阪市角田1-9-29
TEL (072) 965-6231 FAX (072) 962-6236
http://www.krautkramer.co.jp

ISO 9001:2008



認証事業所：本社、大阪事業所

J-sds-21-1011-5h



日本クラウトクレーマー株式会社

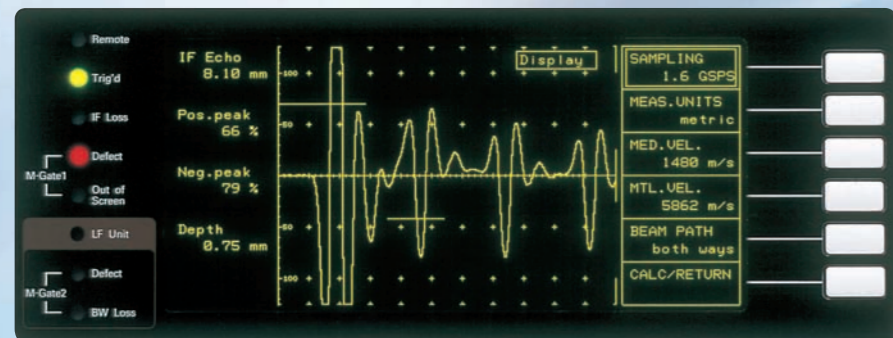
超音波探傷映像化装置 SDS-WIN[®]

SDS-WINシリーズは世界にネットワークを持つ日本クラウトクレーマーが最新の超音波探傷技術と画像処理技術を結晶させた万能装置です。航空機、鉄鋼、非鉄、原子力、自動車、新素材及び半導体等各分野のニーズにお応えします。超音波探傷器には新開発のHIS3を搭載。Windows[®]による画像解析によりさらに使いやすく、進化しました。



新素材に最適な超音波探傷器 HIS3

高速・広帯域超音波探傷器HIS3は日本クラウトクレーマーが独自に開発した最新のデジタル探傷器です。一般用途から超高周波帯域の特殊用途まですべてをカバーします。特に水浸高速探傷アプリケーションに最適な万能器として威力を発揮します。



最新の映像処理技術

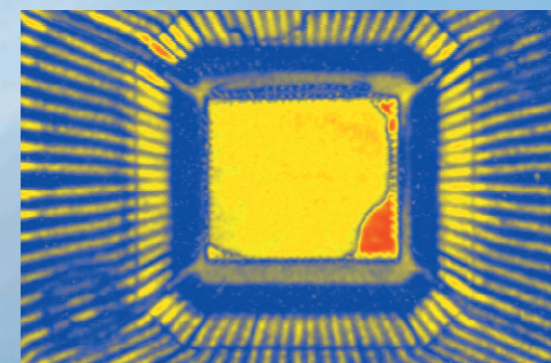
探傷走査中は、リアルタイムでCスコープまたはB・Cスコープを表示し、走査終了後は独自の映像処理により解析、評価を行うことができます。エコー高さ、ビーム路程表示に加え弊社独自のM.U.R.A.I.処理法にて、2値化、2色、16階調カラー表示または多彩な256階調カラーグラデーション表示でモニタ上に表示され、目的とする欠陥映像をより明瞭に得ることが出来ます。探傷結果はカラープリンタで印刷、あるいはフロッピー・MOなどに電子データで保存することができます。

MURAI処理

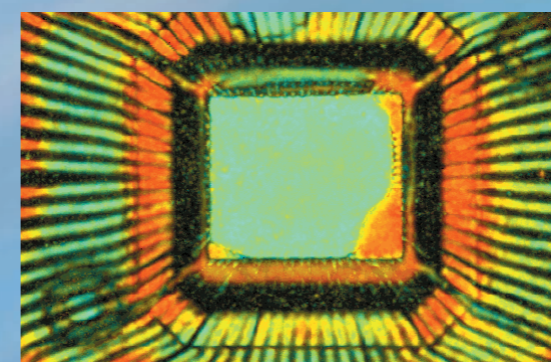
HIS3とポリマー探触子から得られる高ダンピング波形を弊社独自のマトリクス処理にて評価する手法です。エコー強度に位相情報を加えた評価をし、従来困難であった接着と剥離、ポイドと介在物の識別を可能にしました。

(特許:No:2896385)

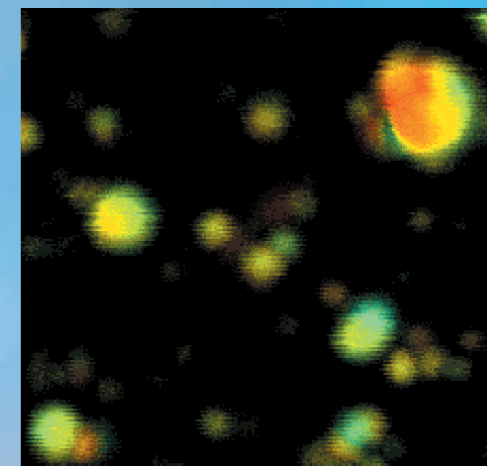
半導体検査適用例/50MHz



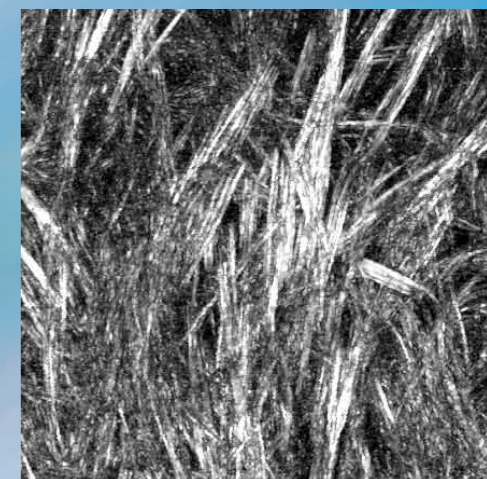
●通常エコー高さ評価



●MURAI処理による界面剥離検出(赤色部)



●鋼材中のポイド(赤)と介在物(青)/80MHz



●ガラス繊維複合材の配向状態検査/125MHz

豊富な走査パターン

SDSの6軸高精度スキャナは豊富な走査パターンを持ち、スタート、エンドの2点ティーチングにより走査条件が自動設定されます。

